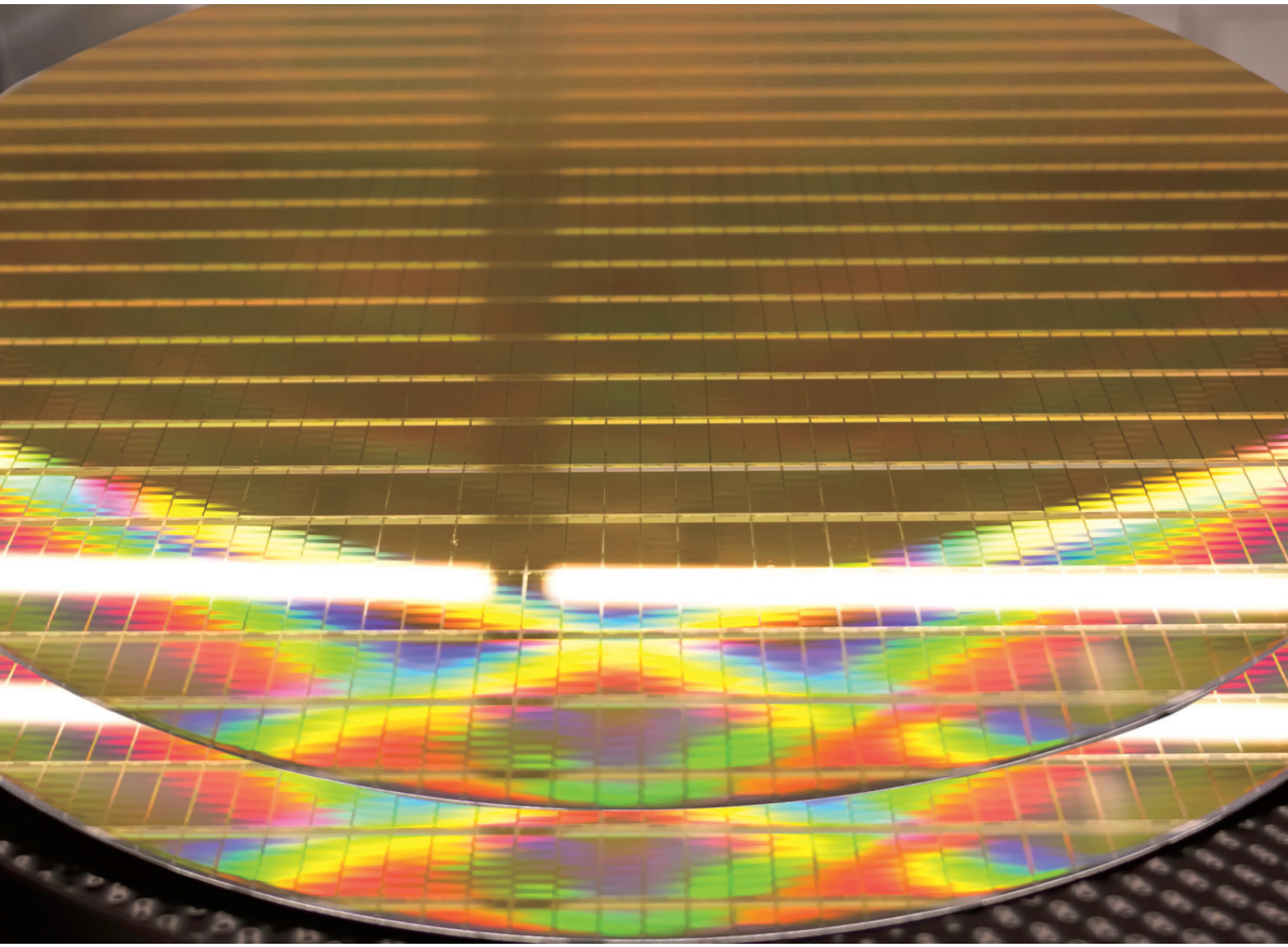
コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.29
No.53

OCTOBER. 2021



Contents

Technical Report A　半導体ウエハ向けナノトポグラフィ測定システムの開発 ―― 1
Technical Report B　半導体ウエハ向けエッジ形状および直径測定装置新型LEP−3200FEの開発 5
Technical Report C　半導体デバイス用極薄膜微細構造の複合解析 ―― 9
Technical Report D　導電性DLCコーティングの半導体検査用プローブへの応用 ―― 13
Technical Report E　電子デバイスのエレクトロマイグレーション解析 ―― 17
Technical Report F　ナノスケール領域における熱伝導シミュレーション技術 ―― 21
■コラム「ここにも科学」：無から「青」が生まれる摩訶不思議なる藍染めの科学 ―― 25
Focus 技術再発見　お客さまと歩み続けた20年：ウエハの形状測定装置 ―― 26
電界放出型オージェ電子分光法（FE-AES）による表面・微小領域解析 27
機能性材料の開発を支える、DSCをもちいた熱分析技術 ―― 28
■新技術・新製品のご紹介 ―― 29　■コベルコ科研社員の学協会発表記録 ―― 31
■コラム【#こべるにくす】：古代からの技術が可能にする「新世代半導体」 ―― 裏表紙